

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2025-008

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

## 杭州立昂微电子股份有限公司

### 关于拟签署投资协议书暨设立全资子公司的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 公司拟与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会签署《投资协议书》，在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”，项目计划总投资12.3亿元。
- 本次交易事项已经公司第五届董事会第七次会议审议，无需提交公司股东大会审议。
- 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。
- 特别风险提示：本次拟签署《投资协议书》具体签约情况及约定的投资项目实施情况存在变动可能性，项目投资金额以未来实际情况发生为准。后续协议各方向项目公司实际增资情况具有不确定性，公司将根据实际增资情况另行审议、评估、披露。外延片项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

#### 一、对外投资概述

##### （一）交易概况

杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）拟与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会签署《年产96万片12英寸硅外延片生产项目投资协议书》（以下简称“投资协议书”），约定公司在嘉兴市南湖高新技术产业园区投资“年产96万片12英寸硅外延片项目”（以下简称“外延片项目”）。外延片项目计划总投资12.3亿元，其中固定资产投资11.2亿元。

##### （二）审议程序

2025年2月14日，公司召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司拟签署〈投资协议书〉的议案》，上述议案无需提交公司股东大会审议。

(三) 本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，预计不存在重大法律障碍。

## 二、拟签署协议对方的基本情况

名称：嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会

统一社会信用代码：113304020025505751

地址：浙江省嘉兴市南湖区亚中路473号

公司与嘉兴市南湖高新技术产业园区管理委员会不存在关联关系。

## 三、拟签署协议的主要内容概要

甲方：嘉兴南湖高新技术产业园区管理委员会

社会统一信用代码：113304020025505751

乙方：杭州立昂微电子股份有限公司

社会统一信用代码：91330100736871634P

乙方在甲方辖区内投资外延片生产项目，与市、区及甲方合资注册成立新公司（以下简称“项目公司”），注册资金5亿元。先期由乙方成立全资子公司，注册资金1亿元，剩余注册资金具体投资细则及股权投资协议另行商议签订。该项目计划总投资12.3亿元，其中固定资产投资11.2亿元。预计项目全部建成达产后形成年产96万片12英寸硅外延片的生产能力。项目在金瑞泓微电子（嘉兴）有限公司（以下简称“嘉兴金瑞泓”）厂房内实施。

## 四、子公司基本情况

公司前期已在嘉兴市南湖区设立全资子公司金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司，公司计划以该全资子公司做为实施外延片项目的项目公司，具体信息如下：

公司名称	金瑞泓昂芯微电子（嘉兴）有限公司
注册资本	10,000万元
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码	91330402MAE9BF9GXM
法定代表人	凤坤
住所	浙江省嘉兴市南湖区大桥镇新昌路1697号2幢
成立日期	2025年1月7日
经营范围	一般项目：电子专用材料制造；集成电路芯片及产品制造；

	半导体分立器件制造；电子专用材料研发；电子专用材料销售；半导体分立器件销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东信息	公司出资比例100%

## 五、对上市公司的影响

近年来，受益于公司硅片业务下游功率器件、模拟芯片市场规模的高速增长，外延片的市场需求也持续扩张。鉴于公司控股子公司嘉兴金瑞泓已于 2024 年底建成 15 万片/月的 12 英寸硅抛光片产能，为满足客户高性能集成电路对于硅片生长外延的需求，公司计划在嘉兴金瑞泓 12 英寸先进制程轻掺抛光片的基础上进一步延伸外延片产能，以满足客户的需求，完善公司的战略布局。外延片项目有利于提升上市公司持续经营能力，符合公司的发展战略和长远规划，符合公司全体股东的利益。

外延片项目投资的资金来源主要为自有资金和自筹资金，建设周期约为 5-8 年，由于本项目建设尚需一定的时间周期，本次拟签署的《投资协议书》短期内不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，预计对公司 2025 年度的经营业绩不会构成重大影响。

## 六、特别风险提示

本次拟签署《投资协议书》具体签约情况及约定的投资项目实施情况存在变动可能性，项目投资金额以未来实际情况发生为准。后续协议各方向项目公司实际增资情况具有不确定性，公司将根据实际增资情况另行审议、评估、披露。外延片项目实施完成后可能面临因市场竞争加剧、行业景气度不及预期等多方面不确定因素带来的业绩波动加剧的风险，敬请广大投资者注意投资风险。

公司将根据交易事项的进展按照《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》的规定履行相应的信息披露义务。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 15 日